

Fubon Global Equity Division

2026 年 07 月 28 日

Amkor Technology, Inc. (AMKR)

公司簡介

是全球領先的半導體封裝與測試外包 (OSAT) 大廠，規模僅次於日月光。

Amkor 專注於提供高效能倒裝晶片、晶圓級封裝 (WLP) 及系統級封裝 (SiP) 服務，廣泛應用於 5G、汽車、物聯網與 HPC。



基本資訊

收盤價	\$60.71
產業別	半導體材料及設備
市值 (百萬)	\$15,048.34
流通在外股數 (百萬)	248
過去1年股價區間	\$20.87 - \$96.68

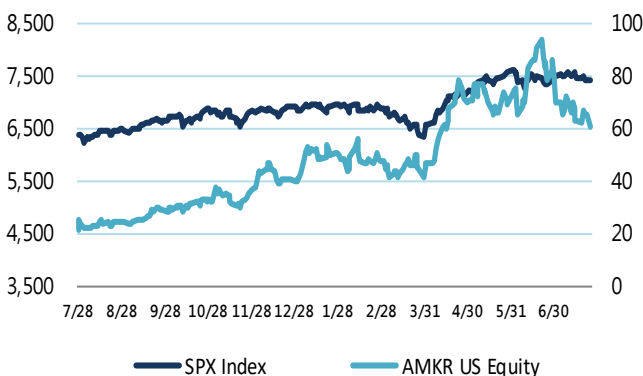
分析師預估

12個月目標價	\$83.55
評等	
買進	8
持有	4
賣出	1

股價表現

5日股價漲跌幅	-3.0
近1月股價漲跌幅	-22.9
近3月股價漲跌幅	-19.7
近12月股價漲跌幅	186.9
YTD	53.8

近期股價走勢



季損益表

	F2Q26A	F3Q26F	F4Q26F	F1Q27F
營收	1,898	2,112	2,049	1,871
YoY%	25.58	6.31	8.50	11.05
毛利率	16.80	16.36	17.33	16.43
EBIT	200	213	221	158
Net income	174	163	182	117
non-GAAP EPS	0.70	0.65	0.67	0.46

年損益表

	FY25A	FY26F	FY27F	FY28F
營收	6,708	7,653	8,566	9,358
YoY%	6.18	14.09	11.93	9.25
毛利率	14.00	15.87	17.47	18.20
EBIT	467	680	843	1,027
Net income	374	538	663	794
non-GAAP EPS	1.50	2.14	2.59	3.21

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

座談重點摘要

1. 管理層指出，AI 資料中心需求持續擴大，Computing 業務第二季創歷史新高，第三季預估將季增近 30%，主要受惠 AI 資料中心需求以及 HDFO CPU 專案放量。除目前量產中的 CPU 專案外，今年仍有多項 2.5D 及 HDFO 專案將陸續推出，Bridge 等新一代封裝技術則預計於 2028 年開始貢獻，顯示 AI 先進封裝產品線仍具長期成長動能。
2. 第三季通訊業務將罕見低於季節性表現，主要受到 SiP 產能由韓國轉移至越南、記憶體供應限制及客戶拉貨時程改變影響，其中 SiP 轉移影響將延續至第四季甚至 2027 年上半年。不過，韓國釋出的產能將優先配置高附加價值 AI 及先進封裝產品，有助於提升整體產品組合及長期競爭力。
3. 管理層表示，第二季毛利率改善約三分之二來自產能利用率提升，三分之一來自產品組合改善；第三季毛利率進一步提升則主要由 AI 運算產品快速放量帶動產品組合升級。惟 2027 至 2028 年 Arizona 新廠進入投產初期仍將承擔折舊及低利用率成本，短期將對毛利率及營業利益率形成壓力，但仍不影響長期成長策略。

公司近況更新

1. 2026 年第二季營收達 19.0 億美元(YoY+26%、QoQ+13%)，毛利 3.19 億美元(YoY+75%、QoQ+33%)，毛利率提升至 16.8%；營業利益 2.00 億美元，營業利益率 10.5%；淨利 1.75 億美元，EPS 達 0.70 美元(YoY+218%、QoQ+106%)，主要受惠於 AI、高效能運算(HPC)及先進封裝需求強勁，帶動產能利用率及產品組合持續改善。
2. 第二季各終端市場皆較去年同期成長，其中通訊業務占營收 42%，運算業務占 22%，汽車、工業及其他業務占 22%，消費業務占 14%。運算以及汽車與工業業務營收皆創歷史新

高，上半年營收年增 26%，Advanced Products 營收占比已提升至 82%，反映 AI、高效能運算及先進封裝需求持續帶動產品組合升級。

3. 公司持續擴充先進封裝及測試產能，深化與 TSMC 及 NVIDIA 策略合作，並推進 Arizona、韓國、越南及台灣等地擴產計畫。第三季營收預估 19.5 億至 20.5 億美元(中位數 20.0 億美元)，毛利率 18.5%至 19.5%(中位數 19.0%)，反映 AI 資料中心及高階封裝需求可望持續支撐營運成長。

Q&A

Q：第三季手機業務展望為何？SiP 轉移對營運影響多久？

A：第三季通訊業務將低於往年季節性表現，主要受到三項因素影響，包括記憶體供應受限、終端市場拉貨模式改變，以及 SiP 產能由韓國轉移至越南。其中前兩項屬於市場因素，約占影響的一半；另一半則來自 SiP 產能轉移。SiP 轉移主要為提升生產效率及成本競爭力，將成熟 SiP 產品移至越南量產，騰出韓國產能支援高附加價值 AI 及先進封裝產品。部分客戶已進入量產，部分仍處於導入或認證階段，因此影響不僅限於第三季，部分產品線將延續至第四季甚至 2027 年上半年。Android 需求仍受到記憶體供應及終端需求影響，iOS 需求相對穩定，但整體智慧型手機出貨量仍預期低於去年。

Q：AI 先進封裝專案進度如何？2027 年後有哪些新成長動能？

A：目前 2.5D 已有 11 家客戶、多項產品同步開發，HDFO 已有 5 家客戶及 10 項開發案，今年仍預計有 4 項 HDFO 產品正式量產。資料中心 CPU 專案已於第二季開始放量，並將於下半年持續提升出貨規模，為目前規模最大的 AI 專案。Bridge 等新一代封裝技術仍依規劃推進，預計 2028 年開始貢獻營收，整體 AI 封裝產品組合及客戶開發進度皆符合先前 Investor Day 規劃。

Q：NVIDIA 策略合作對研發費用及財務有何影響？

A：與 NVIDIA 合作模式並不會改變既有先進封裝共同開發流程，研發投入仍維持過去水準，每年約占資本支出的 3%至 5%，不會因合作案而大幅增加。合作款項屬於預付款形式，預計 2027 年收取，後續將隨著美國廠提供先進封裝服務逐步認列，合作期間預估約 5 至 10 年。

Q：第二季及第三季毛利率改善主要來自哪些因素？

A：第二季毛利率較第一季提升逾 250 個基點，其中約三分之二來自產能利用率提升，約三分之一來自產品組合改善。第三季毛利率預估進一步提升至 18.5%至 19.5%，主要推動力將轉為產品組合改善，隨著 AI 資料中心及 Computing 產品快速放量，加上通訊產品比重下降，整體高毛利產品占比提升，可望持續帶動獲利能力改善。

Q：目前產能利用率是否仍有提升空間？

A：第二季整體產能利用率已由第一季約 70%提升至接近 80%，先進封裝產線已接近滿載。SiP 設備轉移期間部分設備仍處於搬遷、安裝及認證階段，因此未完全反映於實際利用率。成熟封裝產線仍保有部分閒置產能，尤其菲律賓廠仍有可利用空間，整體而言高利用率已開始明顯帶動獲利能力改善。

Q：第二季是否存在客戶提前拉貨情況？

A：除通訊產品可能有少量提前拉貨外，其餘 Computing、Automotive 及 Industrial 等終端市場並未觀察到明顯提前拉貨現象。第二季營收優於預期主要反映終端需求強勁，而非客戶提前建立庫存。

Q：第四季毛利率是否仍有持續改善空間？

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

A：第四季毛利率仍將主要取決於產品組合及產能利用率。若 AI 運算產品維持目前成長速度且高產能利用率持續，第四季毛利率可望維持與第三季相近水準，不預期出現明顯變動。

Q：2027 年至 2028 年獲利展望需要留意哪些因素？

A：2026 年獲利改善速度快於原先中期目標，但 2027 年至 2028 年仍須考量 Arizona 新廠開始投產所帶來的固定成本及折舊負擔。新廠初期產能利用率仍低，因此將對毛利率及營業利益率形成短期壓力，也是 2028 年獲利率未能同步大幅提升的主要原因，待後續產能利用率逐步提升後，長期獲利能力仍可持續改善。

公司近期新聞

1. [Amkor Technology Announces Strategic Partnership with NVIDIA to Expand Advanced Packaging and Test for Next-Generation AI Infrastructure](#)
2. [TSMC and Amkor Technology Announce Long Term Partnership to Accelerate Advanced Packaging in the United States](#)
3. [Amkor Technology Expands U.S. Advanced Packaging Footprint with Additional Land in Arizona](#)

近期投行報告觀點

公司在先進封裝領域的布局逐步進入收成階段，隨著 AI 伺服器 CPU 需求增長，資料中心相關業務占比可望快速提升，並積極參與 NVIDIA Vera CPU、GB10、N1X 及 AMD Venice 等新一代產品封裝專案，帶動先進封裝營收貢獻顯著增加。同時汽車、工業及通訊等傳統業務需求逐步回溫，搭配產業產能趨緊及價格調漲，有助推升整體獲利能力。

所持看好理由：

- AI 伺服器 CPU 與資料中心相關封裝專案陸續放量，將成為未來重要成長來源。
- 運算業務占比持續提升，產品組合朝高附加價值應用發展，有助帶動營收成長。
- 產能利用率改善與價格調整效益逐步顯現，可望推升整體獲利能力。

提醒留意風險：

- AI 相關專案導入或量產進度延後，將影響先進封裝業務成長。
- 亞利桑那新廠建置與擴產執行不如預期，恐拖累獲利表現。
- 終端需求回落或產業景氣轉弱，可能影響傳統封測業務復甦力道。



主要研究機構分析師評等

券商名稱	分析師	評等	目標價	日期
Aletheia Capital Limited	Angus Lin	buy	92	2026/7/23
Goldman Sachs	James Schneider	neutral	65	2026/4/28

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales- 楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com

郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	賴柔璇 Angie ext. 61833 angie.lai@fubon.com		

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。